

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Modicon M580, moduł procesora, poziom 1, wzmocniony

BMEP581020H

Parametry podstawowe

Gama produktów	Modicon M580
Typ produktu lub komponentu	Moduł procesora
Zastosowanie produktu	Do surowych warunków zewnętrznych

Parametry uzupełniające

liczba racków	4
Local I/O processor capacity (discrete)	1024 WE/WY
Local I/O processor capacity (analog)	256 WE/WY
Number of application specific channel (local rack)	36
specyficzne WE/Wy aplikacji	Połączenie szeregowo Licznik Dokładne datowanie Sterowanie ruchem Enkoder SSI HART
Diagnostyka pamięci	Sterowanie procesem
kanaly sterowania	Pętle programowalne
połączenie typu zintegrowanego	1 Ethernet TCP/IP dla port usługowy 2 Ethernet TCP/IP dla sieć urządzeń Port USB typ mini B
liczba rozmieszczonych urządzeń	64
procesor modułu komunikacyjnego	2 moduł komunikacji Ethernet 2 moduł interfejsu AS
obsługa komunikacji	Skaner DIO
opis pamięci	Zintegrowany RAM, 4 MB dla program Zintegrowany RAM, 384 kB dla dane Nadający się do rozbudowy Flash, 4 GB dla przechowywanie danych Zintegrowany RAM, 10 kB dla pamięć systemu
struktura aplikacji	1 cykliczne/okresowe zadanie główne 64 zdarzeń zadaniowych 1 okresowe szybkie zadanie 2 zadania pomocnicze
liczba rozkazów na ms	30 Kinst/ms 65 % Boole'owska + 35 % ustalona arytmetyka 40 Kinst/ms 100 % Boole'owski
obciążenie prądowe	270 mA w 24 V DC
średni czas między awariami (MTBF)	775000 H
Oznakowanie	CE

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Środowisko pracy

Odporność na wibracje	3 gn
Odporność na wstrząsy	30 gn
temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...70 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...85 °C
wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...2000 m 2000...5000 m ze współczynnikiem ograniczenia parametrów znamionowych
wilgotność względna	5...95 % w 55 °C bez kondensacji
Stopień ochrony IP	IP20
wytyczne	2014/35/EU - low voltage directive 2014/30/EU - electromagnetic compatibility 2014/34/EU - ATEX directive
certyfikacja produktu	CE UL CSA RCM EAC Merchant Navy ATEX zone 2/22 IECEX zone 2/22
Normy	IEC 61131-2 IEC 61010-2-201 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No 61010-2-201 IACS E10 EN/IEC 61000-6-5, interface type 1 and type 2 EN/IEC 61850-3, location G IEC 60079-0
odporność na czynniki środowiskowe	Gas resistant class Gx zgodnie z ISA S71.04 Gas resistant class 3C4 zgodnie z IEC 60721-3-3 Odporny na kurz class 3S4 zgodnie z IEC 60721-3-3 Sand resistant class 3S4 zgodnie z IEC 60721-3-3 Salt resistant level 2 zgodnie z IEC 68252 Mold growth resistant class 3B2 zgodnie z IEC 60721-3-3 Fungal spore resistant class 3B2 zgodnie z IEC 60721-3-3 Lokalizacja niebezpieczna klasa I div. 2
Pokrycie ochronne	Conformal coating
zasilanie	Zasilacz wewnętrzny na stojak
lampka led LED informująca o stanie łącznika	1 lampka LED (zielony) praca procesora (RUN) 1 lampka LED (Czerwony) procesor lub awaria systemu (ERR) 1 lampka LED (Czerwony) błąd modułu WE/WY 1 lampka LED (zielony) trwa pobieranie (DL) 1 lampka LED (Czerwony) błąd karty pamięci lub CPU (BACKUP) 1 lampka LED (zielony/czerwony) ETH MS (status konfiguracji portu Ethernet) 1 lampka LED (zielony/czerwony) Eth NS (stan sieci Ethernet)
Masa produktu	0,849 kg

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	9,000 cm
Szerokość opakowania 1	18,000 cm
Długość opakowania 1	25,300 cm
Waga opakowania 1	892,000 g
Jednostka miary opakowania 2	S03

Ilość jednostek w opakowaniu 2	6
Wysokość opakowania 2	30,000 cm
Szerokość opakowania 2	30,000 cm
Długość opakowania 2	40,000 cm
Waga opakowania 2	5,720 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie >](#)

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów >](#)

Wpływ na środowisko

Ślad węglowy (kg ekwiwalentu CO2 na CR, całkowity cykl życia)	230
---	-----

Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
---	--

Use Better

Materiały i opakowania

Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Tak
---	-----

Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Nie
--	-----

Numer SCIP	4eb70ab0-978b-4773-a441-0cc20d6144a1
------------	--------------------------------------

Chińskie rozporządzenie RoHS	Dyrektywa RoHS Chiny
------------------------------	--------------------------------------

Use Again

Przepakowanie i regeneracja

Profil cyklu życia produktu (PEP)	Informacja o żywotności
-----------------------------------	---

WEEE	 Produkt musi być utylizowany na rynkach Unii Europejskiej zgodnie wytycznymi dotyczącymi zbiórki odpadów i nigdy nie może trafić do pojemników na śmieci.
------	---

Odbiór	No
--------	----

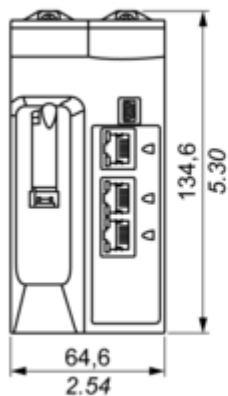
Arkusz danych produktu

BMEP581020H

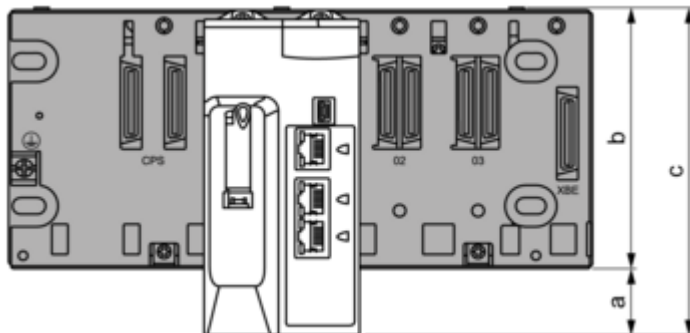
Dimensions Drawings

CPU Module Only

mm
in.



Modules Mounted on Racks

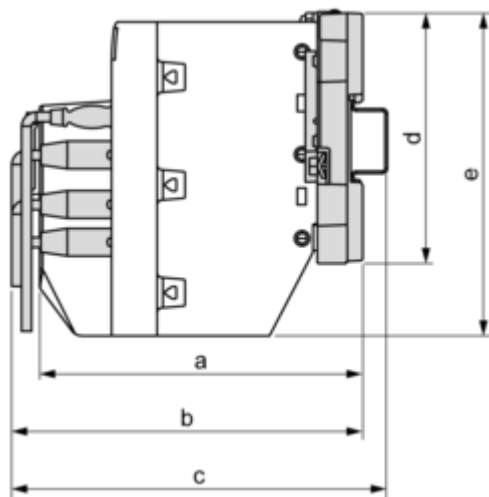


a: additional space below the rack to accommodate the height of the CPU. For an X Bus rack, the value is 30.9 mm (1.217 in.); for an Ethernet rack, the value is 29.49 mm (1.161 in.).

b: the height of the rack. For an X Bus rack, the height is 103.7 mm (4.083 in.); for an Ethernet rack, the height is 105.11 mm (4.138 in.).

c: the height of the main local rack, 134.6 mm (5.299 in.)

Modules and Cables Mounted in an Enclosure



a: enclosure depth: 135 mm (5.315 in.)

b: wiring + module depth: > 146 mm (5.748 in.)

c: wiring + module + DIN rail depth: > 156 mm (6.142 in.)

d: rack height: for an X Bus rack 103.7 mm (4.083 in.); for an Ethernet rack, 105.11 mm (4.138 in.)

e: module height: 134.6 mm (5.299 in.)